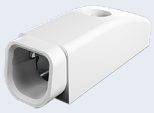
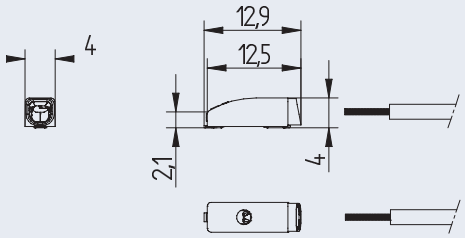
SMD-Leiterplattenklemmen

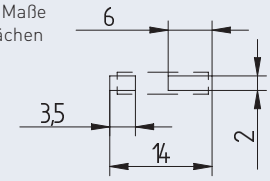
46.131 · SMD-Leiterplattenklemme - MiniFlex





Generelle Empfehlung: Die beiden Lötflächen eines Klemmpoles auf der Platine sollten elektrisch miteinander verbunden werden

Empfohlene Maße für die Lötflächen



SMD-Leiterplattenklemme MiniFlex mit Steckkontakten und Kontaktöffnungsfunktion

1-polig - 46.131.2001.50

Direktes Stecken von eindrähtigen und feindrähtig, verzinnten Leitern, sowie feindrähtigen Leitern durch Betätigen der Kontaktöffnungsfunktion

Kontaktöffnungsfunktion- auch zum Lösen bereits eingesteckter Leiter

Montage- und Verdrahtungsposition: Leiterplatte oberseitig

Automatengerechte "Tape-and-Reel" Verpackung

Befestigung: Bleifreie Reflow-Lötung nach DIN EN 610760-1, Abschnitt 6

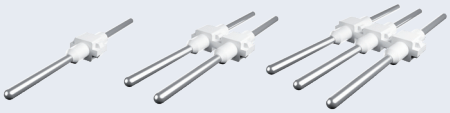
Material: Gehäuse: PPA, weiß
Kontaktwerkstoff: CuNi
Kontakoberfläche: feuerverzinnt

Zur Betätigung der Kontaktöffnungsfunktion, empfehlen wir den Einsatz unseres Werkzeugs **46.131**.U802.89 und **46.131.**-397.80

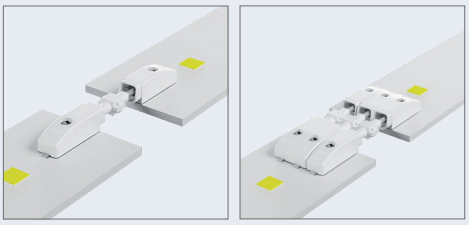
Daten zur Verpackung 46.131.2001.50	
Gewicht SMD-Klemme	0.24 g
Anzahl Klemmen pro Spule	2.650 Stück
Spulendurchmesser Gurtverpackung	381 mm (15")
Gurtbreite	24 mm
Pitchabstand	8 mm
Gewicht pro Spule	1.092 kg
Anzahl Spulen pro Karton	13 Stück
Anzahl SMD-Leiterplattenklemmen pro Karton	34.450 Stück
Gewicht pro Karton	15.46 kg
Abmessungen Karton (LxBxH)	400 x 405 x 400 mm

Gew.	Verp.	Artikel-Nr.
0.24 g	2650	**46.131.**2001.50

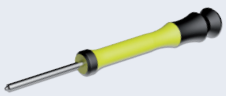
Zubehör:
SMD Mini-Flex-B2B-Verbinder. Zur Verbindung von Leiterplatten. Die Verbinder sind in den Längen 26 mm (U701), 28 mm (U702) und 30 mm (U703) erhältlich.



46.131 **46.132** **46.133**



Werkzeug zur Kontaktöffnung
Zum Öffnen der Kontakte bei Einsatz von feindrähtigen Leitern oder zur Entnahme bereits eingesteckter Leiter.



46.131.U802.89

46.131.-397.80

Integrierte Abisolierfunktion bei bereits angezogenen Leiterenden

Diese Seite ist nur gültig im Zusammenhang mit den allgemeinen Informationen unter www.bjb.com/Allgemeine-Informationen-zu-BJB-Produkten, sowie den Informationen zu dem betreffend Produkt unter www.bjb.com.

SMD-Leiterplattenklemmen

46.131 · SMD-Leiterplattenklemme - MiniFlex
Allgemeine technische Hinweise

technology for light

Anschlussdaten	
Anschlusstechnik	Steckkontakt
Eindrähtige Leiter	0.20 - 0.75 mm², AWG 24-18
Feindrähtige, verzinnte Leiter	0.20 - 0.5 mm², AWG 24-20
Feindrähtige Leiter	0.20 - 0.75 mm², AWG 24-18
Abisolierlänge (ø < 2.1 mm)	8 +1 mm
Abisolierlänge (ø 2.1 - 2.7 mm)	9 +1mm
Leitereinführung	0°
Leiterlösefunktion mittels	Werkzeug zur Kontaktöffnung
Auszugskraft nach DN 60999-1	
0.2 mm²	min. 10 N
0.34 mm²	min. 15 N
0.5 mm²	min. 20 N
0.75 mm²	min. 30 N
Einsteckkraft	max. 10 N

Geometrische Daten	
Rastermaß	4 mm / 0.16 inch
Breite	4 mm / 0.16 inch
Höhe	4 mm / 0.16 inch
Tiefe	12.9 mm / 0.51 inch
Spulendurchmesser Gurtverpackung	381 mm (15")
Gurtbreite	24 mm
Pitchabstand	8 mm
Verpackungseinheit Tape-and-Reel	2.700 tbc
Verpackungseinheit Karton	35.100 (13 Spulen) tbc

Werkstoffdaten	
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff	PPA, weiß
PTI	600
Entflammbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Kontaktwerkstoff	CuNi
Kontakoberfläche	feuerverzinnt

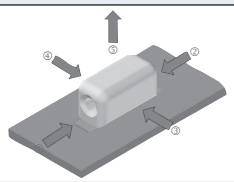
Mechanische Daten	
Montageposition	Leiterplatte oberseitig
Befestigungsart	Bleifreies Reflow-Löten

Temperaturbedingungen	
Grenztemperaturbereich	-40 °C bis + 150 °C
Umgebungstemperatur	-40 °C bis + 105 °C
T-Klassifizierung nach IEC 60998-1 Abs. 12	120°

Bemessungsdaten gemäß IEC / EN 60947-7-4 (IEC/EN 60664-1	
Bemessungsspannung (III / 3)	63 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	2.5 kV
Bemessungsspannung (III / 2)	160 V
Bemessungsstoßspannung (III / 2)	2.5 kV
Bemessungsspannung (II / 2)	320 V
Bemessungsstoßspannung (II / 2)	2.5 kV
Bemessungsstrom	9 A

Bemessungsdaten gemäß UL 1977	
Bemessungsspannung UL 1977	320 V
Bemessungsstrom UL 1977	9 A

Länderspezifische Zulassungen Zertifikate	
VDE ENEC	EN 60947
UL	cURus, File No. E-365006

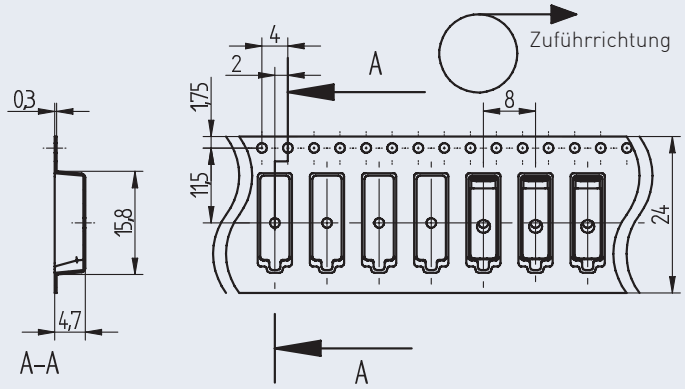
Scherkräfte nach IEC 62137-1-2: 2007. Bei diesen Werten handelt es sich um Maximumwerte, die nur für eine kurzzeitige Belastung gelten, nicht für Dauerbelastung.	
Richtung 1 + 2 Scherkraft längs	50
Richtung 3 + 4 Scherkraft quer	20
Richtung 5 Abzugskraft	20

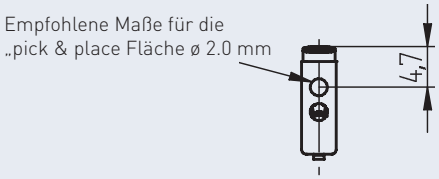
Diese Seite ist nur gültig im Zusammenhang mit den allgemeinen Informationen unter www.bjb.com/Allgemeine-Informationen-zu-BJB-Produkten, sowie den Informationen zu dem betreffend Produkt unter www.bjb.com.

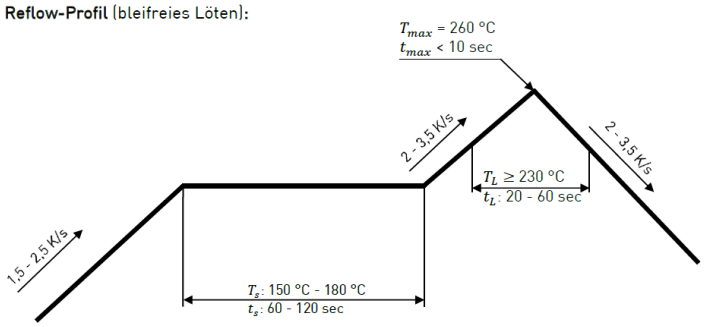
Hinweise zur Verarbeitung

Geeignet für bleifreie Reflow-Lötprofile in Anlehnung an DIN EN 61760-1 bzw. DIN EN 60068-2-58 bis zu einer Peak-Temperatur von max. 260 °C.
Aufgrund von unterschiedlichen anwendungsspezifischen Einflussgrößen (Bauteilanordnung und -ausrichtung, Lötanlage, Lötpaste) wird empfohlen, mittels Testläufen ein geeignetes Profil unter Fertigungsbedingungen zu ermitteln.

Abhängig vom SMD-Prozess und den Lötparametern kann eine leichte Verfärbung auftreten, welche jedoch die technische Funktionsweis nicht beeinflusst.





Lagerdauer	Lötbarkeit bei Lagerung zwischen -5°C und +40°C bei 10 - 60 %rH bis zu 6 Monaten. Bei Verarbeitung nach mehr als 6 Monaten sollte die Lötbarkeit gemäß J-STD-002D oder DIN EN 60068-2-58:2016 überprüft werden.
max. zulässige Reflowvorgänge	3
Lötprofil	**Reflow-Profil** (bleifreies Löten): 
Lötbarkeit	Lötbarkeit der Bauteile ist durch Benetzungstest gemäß J-STD-002D geprüft
Montageverfahren	SMD, nach Zeichnung
Materialstärke SMD-Schablone	100 - 150 µm (Empfehlung BJB 150)

Diese Seite ist nur gültig im Zusammenhang mit den allgemeinen Informationen unter www.bjb.com/Allgemeine-Informationen-zu-BJB-Produkten, sowie den Informationen zu dem betreffend Produkt unter www.bjb.com.